U3-3680XLE-M-GL (AB03032)

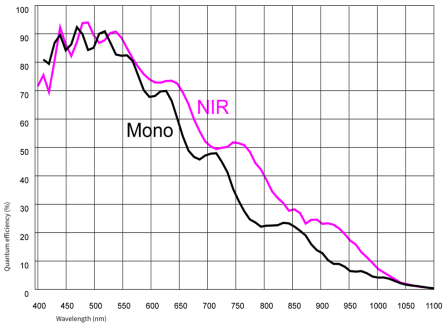
■ 生産終了
このカメラモデルは生産終了となりました。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	ローリングシャッター / グローバル開始シャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	5 MP
有効画素数	5.04 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	2592 x 1944 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.5''
撮像面積	5.702 mm x 4.277 mm
光学センサーの対角	7.13 mm 1/2.5″
画素サイズ	2.2 µm
CRA (主光線角)	9 °
メーカー	Onsemi
センサーモデル	AR0521SR2M09SURA0
ゲイン (マスター/RGB)	15x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	48 / 12
AOI 画像の高さ、ステップ幅	4 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	4 / 2
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング)水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3680XLE-M-GL (AB03032)

モデル

フレームレートフリーランモード	48 fps
フレームレートトリガー（連続）	46 fps
フレームレートトリガー（最大）	46 fps
露出時間（最小～最大）	0.016 ms – 664 ms
消費電力	0.6 W – 1.2 W
画像メモリ	–

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C – 55 ° C / 32 ° F – 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C – 80 ° C / -4 ° F – 176 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % – 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB Type-C
I/O コネクター	–
電源	USB ケーブル

設計

レンズマウント	CS- / C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	47.0 mm x 46.0 mm x 23.9 mm
重量	33 g
ハウジング素材	プラスチック

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	–
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	–
	Long exposure	–
	Line scan	–
	Global start	✓
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	–
画像調整	Auto exposure	–
	Auto gain	–
	Auto whitebalance	–
	Color correction	–
	Gamma	–
	LUT	–
	Mirror/flip	X/Y

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3680XLE-M-GL (AB03032)

統合画像処理

Pixel formats	Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	–
Decimation (Sensor)	
Binning (FPGA)	–
Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

その他

Chunks	–
Sequencer	–
Events	✓
Firmware update	✓
1st supported firmware version	2.6

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp